

Tuotteen Kuvaus

Pikatiedot

Lähtöisin	Guang dong, Kiina (Manner)	Tuotenimi	O-Johtavat
Pohjamateriaalia	FR-4, alumiini	Kuparin paksuus	0.5oz-5oz
Min. Reiän koko	0.2mm	Min. Viivan leveys	0.2mm
Pinnan viimeistely	upotus kulta, OSP, lyijytön HASL	Hallituksen paksuus	0.1-5mm
sovelletaan	led, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesukoneet	merkki	Teollisuuden ohjauspiiri
todistukset	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
paino	0,01 kg -5 kg	MOQ	10kpl
Mallinumero	Power Bank PCB-kokoonpano pcba valmistaja	Min. Riviväli	0.2mm
väri-	sininen, punainen, vihreä, black.yellow	hinta	\$ 0,1- \$ 10
desigh tyyppi	asiakkaan vaatimus	desigh tyyppi	asiakkaan vaatimus

Pakkaus & Toimitus

Pakkaustiedot	Imuroitu tyhjiö
Toimitustiedot	7-9 päivää

Tuotteen Kuvaus

16 vuoden ammattimainen OEM-piirilevyjen valmistus

erä	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte
Kerroslaskenta	32	42	38	44	42	48
Minilähetys / tila (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minin porausreikä halkaisija (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Kuvasuhde PTH: stä	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Mikä tahansa kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levyn täyttö	J00	-	J00	-	J00	-
Min. ydinpaksuus (ei sisällä kuparia) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserporan halkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Via haudattu reikä / pinottu kautta	J00	-	J00	-	J00	-
materiaali	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper jne.					

Sulautettu kondensaattori PCB	J00	-	J00	-	J00	-
Pintaprosessi	Lyijytön HASL, ENIG, OSP, Immersion hopea, Immersio-tina, Flash kulta, kultainen sormisuojaus, selektiivinen kova kullattu pinnoitus, Peitettävä juotosmassiini, Carbon muste					



